

一般社団法人ニューダイヤモンドフォーラム
平成23年度第3回研究会
プログラム

日時： 平成24年1月30日(月) 研究会 13:30 - 17:00
懇親会 17:10 ~

場所： 東京工業大学 大岡山キャンパス石川台3号館
(〒152-8550 東京都目黒区大岡山 2-12-1)
研究会： 304号室
懇親会： 305号室
<http://www.titech.ac.jp/about/campus/index.html>

テーマ： 「切削工具におけるダイヤモンド・cBNへの期待」

プログラム

各講演者：講演40分+質疑10分 合計50分

- 13:30~14:20 (1) ダイヤモンドバイトによる精密加工の新展開
(株)アライドマテリアル 小島 一志 氏
- 14:20~15:10 (2) 航空機材料における切削加工の現状
川崎重工業(株) 田村 純一 氏
- 15:10~15:20 休憩
- 15:20~16:10 (3) cBN 工具による高速ミーリングの現状と課題
芝浦工業大学 安齋 正博 氏
- 16:10~17:00 (4) 切削工具用 cBN 材料とその特性について
京セラ(株) 松澤 正人 氏
- 17:10~ 懇親会